

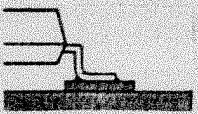


6.1.2 Требования к пайке компонентов с короткими выводами (элементы типов SO, SSOP, QFP).

Таблица 14

Требование к пайке	Графическое изображение	Описание
Предпочтительно		Высота мениска не менее толщины вывода.
Приемлемо		Высота мениска не менее половины толщины вывода.
Требуется переработка		Высота мениска равна или менее половины толщины вывода.

6.1.3 Требования к пайке компонентов с длинными гибкими выводами (элементы типов QFP, VCO).

Таблица 15

Требование к пайке	Графическое изображение	Описание
Предпочтительно		Высота мениска не менее толщины вывода.
Приемлемо		Высота мениска не менее половины толщины вывода.
Требуется переработка		Высота мениска равна или менее половины толщины вывода.

					БЖАК.680242.001 ОТТ		Лист
Изм	Л	N докум.	Подп.	Дата			12
13039/Т		13.09.01					
Инв N подл		Подп и дата		Взам инв N	Инв N дубл	Подп и дата	